



P30 Serie

Halogenfreie Lotpaste

SHENMAO

Merkmale

- Exzellentes Lunkerverhalten
- Geringes Spritzverhalten
- Exzellente Lötbarkeit bei besonders kleinen Bauteilen
- Exzellentes Druckverhalten bei besonders kleinen Bauteilen

ULBRICH Maschinenbau- und Export-Import Betriebsg.m.b.H.
Josefsthaler Strasse 34
A-2512 Tribuswinkel / Austria

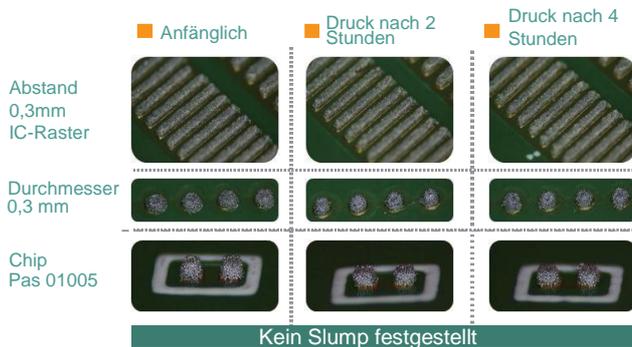
office@ulbrich.at

Lötverhalten bei besonders kleinen Bauteilen



★ Exzellente Lötbarkeit für kleine 01005-Chips

Fortlaufende Druckstabilität

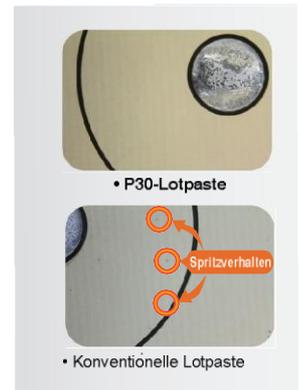


Kein Slump festgestellt

Geringes Spritzverhalten

Testbedingungen:

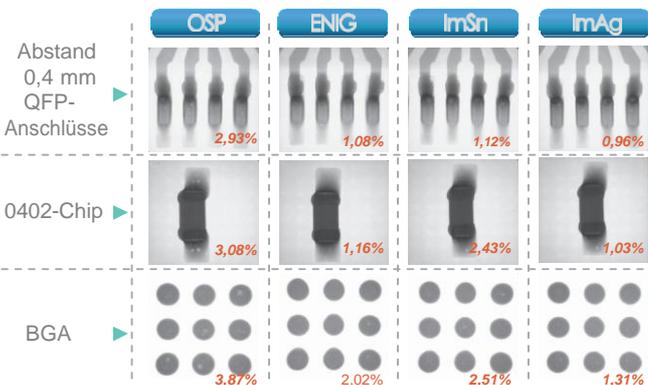
- Oberflächenbeschaffenheit: ENIG
- Schablondicke: 0,15mm
- Schablionenöffnung: Durchmesser 6,5mm
- Heizumgebung: Luft
- Heizprofil: Aufwärmen – Halten – Spitzenwert



Lunkerverhalten

Bedingungen:

- Schablondicke: 0,12 mm
- Oberflächenbeschaffenheit: OSP/ENIG/ImAg/ImSn
- Drucker: Panasonic SP18P-L
- Heizumgebung: Luft
- Heizprofil: Aufwärmen – Halten – Spitzenwert



Exzellentes Lunkerverhalten

Lotpaste	Oberfläche	OSP	ENG	ImSn	ImAg
P30-Paste		2,93%	1,08%	1,12%	0,96%
Konventionelle Lotpaste		5,03%	2,15%	2,51%	1,92%

Basiseigenschaften

Bezeichnung	Legierung	Schmelzpunkt (°C)	Partikelgröße (µm)
Produkt			
PF606-P30	Sn/Ag3.0/Cu0.5/x	217~219	20~38 20~45
PF629-P30	Sn/Ag0.3/Cu0.7	217~226	20~38 20~45
PF632-P30	Sn/Ag1.0/Cu0.5	217~226	20~38 20~45

Bezeichnung	Spezifikation	Standard
Flussmittelzusammensetzung	11,5±1,0 wt%	JIS-Z-3197,8.1.2
Viskosität	200±30Pa · s	JIS-Z-3284, Anhang 6
Flussmitteltyp	ROLO	J-STD-004A
Kupferspiegel	Bestanden	IPC-TM-650, 2.3.32
Streuung	> 70%	JIS-Z-3197, 8.3.1.1
Slump	Bestanden	JIS-Z-3284, Anhang 7, 8
Lotkugel	Bestanden	JIS-Z-3284, Anhang 11
S.I.R.	> 1x10 ⁶ Ω · bestanden	IPC-TM-650, 2.6.3.3
Elektromigrationstest	Bestanden	IPC-TM-650, 2.6.14.1